

## Компаунд заливочный теплопроводящий изоляционный двухкомпонентный

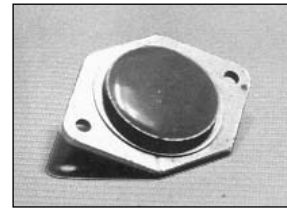
ТУ РБ 100009933.004-2001

- Предназначен для капсулирования и герметизации электронных схем и микросборок путем полной или частичной заливки.
- Полимеризуется при комнатной температуре в течение суток.
- Обеспечивает эффективный теплоотвод от греющих элементов и микросборок.
- Обладает высокой эластичностью, химической инертностью и хорошей адгезией к металлам.
- Толщина заливаемого слоя не ограничена.
- Не выделяет вредных веществ при эксплуатации.
- Диапазон цветов — от светло-серого до черного.

Удельное объемное сопротивление .....  $10^{14}$  Ом·см  
 Теплопроводность ..... 1...2 Вт/(м·К)  
 Электрическая прочность ..... 15 кВ/мм  
 Тангенс угла диэлектрических потерь  
 (при 1000 Гц) .....  $(4-4,5) \cdot 10^{-3}$   
 Рабочая температура ..... -60 — +260 °С

Инструкция по применению состава:

- к 100% массовых частей компонента А добавить 4,0% массовых частей компонента В;
- тщательно перемешать в течение 3–5 минут;
- нанести готовую смесь на изделие (намазыванием, погружением, заливкой...);
- полимеризация происходит на воздухе при комнатной температуре;
- время "жизни" смеси 25–35 мин;
- полная полимеризация длится 24 часа;
- "время жизни" можно увеличить, уменьшив процентное содержание компонента В в смеси.



При температуре до 100 °С прочность, диэлектрические характеристики и удельное объемное сопротивление материала практически не изменяются. Диэлектрическая проницаемость  $\epsilon$  и тангенс угла диэлектрических потерь  $\text{tg } d$  мало чувствительны к изменению частоты, что позволяет использовать материал в высокочастотной технике. При возрастании частоты от 100 до 108 Гц  $\text{tg } d$  изменяется от  $3,0 \times 10^4$  до  $9,5 \times 10^4$  при  $\epsilon = \text{const}$ .

**ПОСТАВКА:** в виде двух компонентов: А-керамико-полимерная композиция, В-катализатор.

При содержании компонента В менее 1,5% полимеризация при комнатной температуре не происходит. Для полимеризации такой смеси требуется нагрев. Температуру нагрева выбирают, исходя из термостойкости заливаемых компаундом материалов. Чем больше температура, тем меньше время полимеризации. Максимальная температура нагрева 200 °С. Для каждого изделия температура подбирается отдельно, исходя из конструкции, массы и материалов, применяемых в изделии.

**ВНИМАНИЕ!** Компонент В хранить в темном месте, в плотно закрытом сосуде.

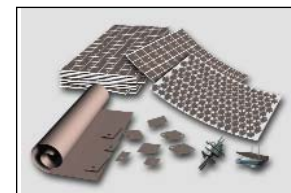
## Эластичные прокладки, армированные стеклотканью

ТУ РБ 100009933.004-2001

**Обеспечивают:**

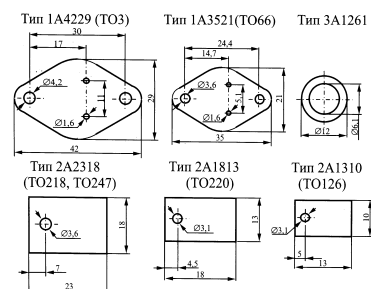
- интенсивный теплоотвод от нагреваемой поверхности;
- монтаж полупроводниковых элементов без нанесения теплопроводящей пасты, что гарантирует чистоту и сокращает время сборки;
- высокую эластичность, гарантирующую надежный контакт в соединении полупроводник-подложка-радиатор;
- снижение себестоимости за счет уменьшения трудоемкости сборки и замены дорогостоящей керамики;
- экологическую чистоту.

Удельное объемное сопротивление .....  $10^{14}$  Ом·см  
 Теплопроводность ..... 1,0...1,2 Вт/(м·К)  
 Пробивное напряжение не менее ..... 3,5 кВ (при толщине 0,22 мм)  
 Тангенс угла диэлектрических потерь  
 (при 1000 Гц) .....  $(4-4,5) \cdot 10^{-3}$   
 Рабочая температура ..... -60 — +260 °С



**Поставка:**

Листами размером 220×150×(0,22±0,02) мм.  
 В виде готовых подложек под стандартные корпуса.



## Изолирующие втулки

- Обеспечивают изоляцию полупроводниковых приборов от корпуса радиатора при креплении винтами.
- Материал — полипропилен.
- Температура эксплуатации до 180 °С.
- Срок изготовления не более 10 дней.
- По желанию заказчика возможно изготовление подложек требуемой формы и размеров.
- Внутренний диаметр 2,5; 3,0 мм.

